

证券代码：688375

证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、东海基金、中金公司、兴业基金、华富基金、华泰保兴、华泰证券、博道基金、国信弘盛私募、国寿安保基金、太平资产、富安达基金、百年资管、观火投研、财通资管、东方证券、国泰基金、方正证券、博时基金、民生加银、合众易晟、英大信托、前海人寿、长江证券、富国基金、景顺长城、岙夏投资、趣时资产、鹤禧私募、东海证券、国信证券、国联安基金、太平养老保险、安信基金、恒越基金、方正富邦、涌贝资产、湘财基金、雪石资产、申万宏源、银华基金、长城基金、国新证券、邮储银行、弘康人寿、兴业证券、国联基金、长城财富、华夏基金、银杏资本、益民基金、汇泉投资、金鹰基金、鹏扬基金、丰源正鑫投资、中荷人保、中信资管、国海证券、银河基金、力元投资、中庸资产、汇丰晋信基金、招商证券、平安基金、上海德焱、垒土资产、景领投资、高特佳投资、光大证券、中汇金投资
时间	2024年5月7日-5月10日
地点	北京、上海、成都
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘洋 证券事务代表 魏兴尧

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、2024 年全年的业绩如何展望？</p> <p>2024 年，公司将加大产品开发力度，依托化合物半导体方面的技术积累，为未来新型有源相控阵 T/R 组件与射频市场的竞争打下坚实的基础。公司拟通过募集资金投资项目的实施，实现产品种类进一步完善、现有产能进一步提升，持续聚焦主营业务发展和核心技术创新，保持良好发展态势。</p> <p>2、2024 年公司的 T/R 组件订单如何展望？截至目前新签订单的情况如何？</p> <p>T/R 组件领域，公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势和制造工艺的长期积累，在各应用平台都取得相关进展。同时，公司紧跟行业发展趋势和重点预研动向，围绕用户需求进行产品策划，积极开拓新的市场。公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已开始交付客户。</p> <p>3、公司手机终端产品今年的订单进展如何？P70 手机中是否有公司产品？</p> <p>公司积极开拓终端领域，多款终端用射频芯片产品已经开始向业内知名终端厂商批量供货。在射频放大类芯片方面，开发完成 WiFi、手机 PA 等产品，性能达到国内先进水平，同时正在进行新产品研发；在射频控制类芯片方面，公司应用于终端的射频开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，产品性能达到国内先进水平。公司将持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足市场需求。具体情况涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>4、2023 年军品订单收入中各应用平台的占比如何拆分？</p> <p>2023 年，公司顺利完成各类重点型号 T/R 组件的生产交</p>
----------------------	--

付，产品销售收入实现稳定增长。由于保密原因，有关 T/R 组件产品的具体信息不便披露。

5、公司在 T/R 组件领域的竞争对手有哪些？所占市场份额如何？

根据公司招股说明书，T/R 组件领域选定的可比公司为雷电微力和天箭科技。公司研制了数百款有源相控阵 T/R 组件，产品市场占有率保持国内领先地位，除整机用户内部配套外，是国内面向各整机单位销量最大的有源相控阵 T/R 组件平台。

6、公司是否面临 T/R 组件订单降价的压力？

公司长期以来一直合理定价，积极应对下游客户要求降价带来的压力，目前主流产品价格均处于较为稳定的状态，影响经营业绩的风险较小。

7、公司卫星业务有何新进展？

在 T/R 组件领域，公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已开始交付客户。在射频集成电路领域，公司已开展卫星通信领域多个射频集成电路的技术研发和产品开发工作，多款产品已被客户引入。

8、目前 T/R 组件新的技术有何突破？

国博电子具备 T/R 组件产品设计平台、高密度高精度三维集成工艺平台以及全自动通用测试平台，积累了关键核心技术，研制了数百款有源相控阵 T/R 组件，其中定型或技术水平达到固定状态产品数十项。公司自主研制的 GaN 射频芯片已在 T/R 组件中得到广泛的工程应用。

公司积极推进射频组件设计数字化转型，重点围绕 W 波段有源相控微系统、低剖面宽带毫米波数字阵列等新领域，持续开展相关关键技术攻关，积极推进异构集成技术产品化技术，为新一代产品开拓打下基础。

9、公司是否有资产注入的计划？

公司未来如有资本运作相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

10、公司限售股解禁之后的减持情况如何？

基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）均出具了《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。截至目前，员工持股平台南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）也暂未进行减持。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，请关注公司披露的相关公告。

11、目前公司产能状况如何？是否有瓶颈？

2023 年，公司按计划完成射频集成电路产业园中试厂房、模块厂房搬迁，同时完成科研生产转场认证及保密资格评审，产能有序提升，产能利用率良好。

12、公司如何看待 5.5G 基站建设，是否会给今年的业绩带来利好？

公司是国内基站射频器件的核心供应商，与国内主流移动通信设备制造商深度合作。

国博电子的 GaN 射频模块完整产品系列覆盖 DC-10GHz，主要应用于 4G、5G 基站设备中，并积极布局 6G 移动通信应用，是全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一。公司推出的新一代金属陶瓷封装 GaN 射频模块及塑封 PAM 等产品在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。公司多款射频集成电路已应用于 5.5G 通感一体基站中，应用于基站新一代智能天线的高线性控制器件业务需求旺盛，并针对 5.5G 通信的发展需求持续进行产品迭代开发和新产品研发。

13、公司应用在基站中的产品单通道价值量有多少？

随着通信技术的不断发展进步，基站中射频器件的价值也同步提升。公司应用在基站中的产品包括射频模块和射频芯片，不同产品的价格不尽相同。

14、公司在组件低成本方面有何统筹策划？

高质量、低成本、可持续一直是行业发展的大势所趋。公司在日常经营管理中注重成本管控，通过精益制造管理提升、工艺优化、自动化生产技术应用等措施来提高生产效率、降低成本，确保盈利能力和利润率保持稳定增长。

15、手机终端用射频芯片的毛利率水平如何？

公司主营业务毛利率保持在一个稳定的区间内，总体呈稳中有升态势。

16、手机终端产品单机价值量有多少？

目前，公司应用在手机终端的射频控制类芯片产品处于量产阶段。2024年，公司将继续加大在射频控制类芯片和射频放大类芯片的研发力度，争取进一步扩大份额，提高单机价值量。

17、2023年公司射频芯片业务营收同比减少较多，原因是什么？

射频芯片营业收入同比减少，主要原因为公司调整产品结构，应用于基站的射频芯片产品同比减少，但应用于手机终端的射频芯片有较大增长。

18、公司应用在卫星领域的产品价值量大概有多少？

公司应用在卫星领域的产品主要应用在卫星载荷部分，其价值量根据不同卫星载荷的价值量而定，在卫星载荷部件中价值占比较高。

19、2023年公司T/R组件中自研芯片的占比有多少？

公司拥有自己专业的芯片研发设计团队，自主研发的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。

	<p>20、公司手机终端的芯片在哪里流片？</p> <p>公司应用在终端领域的芯片，设计部分由公司自主完成，制造、封装测试部分一般采取外协模式。</p> <p>21、公司在手机终端领域一季度的新签订单情况如何？</p> <p>在手机终端领域，客户一季度需求旺盛，新签订单取得较快增长，市场份额有所提升，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。</p>
附件清单（如有）	无
是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2024年5月10日